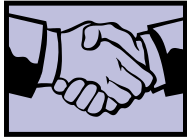


2014 ワークショップ

参加者募集中!

日本ブランド復権のカギを握る実装イノベーション

~ 魅力ある機能・品質・コストへの挑戦 ~

 2014年10月23日(木)~24日(金)
 ラフォーレ修善寺 研修センター


エレクトロニクス実装学会では、今年も実装技術に関するワークショップを10月23日(木)~24日(金)にラフォーレ修善寺(静岡県伊豆市)にて開催いたします!『日本ブランド復権のカギを握る実装イノベーション ~魅力ある機能・品質・コストへの挑戦~』をテーマに掲げ、最先端のポスター発表を42件、特別講演1件、ナイトセッション1件を予定しております。

通常の講演会や学会とは異なり、ポスターの前で、発表者と参加者が一体となった双方向のディスカッションを中心に行います。2日間にわたるセッションの中で、課題解決へのヒントや将来の夢、新たな問題提起や異分野の方々とのネットワーク等、実り多き成果を必ずやお持ち帰りいただけるものと確信しております。

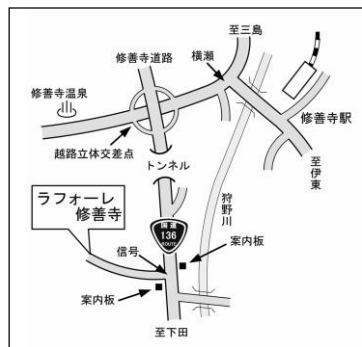
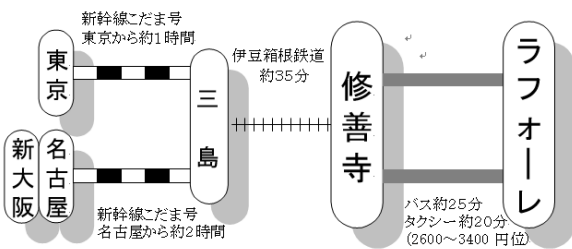
実装分野で日本が世界の牽引役をこれからも果たし続けていくことができるように、「2014ワークショップ」へのご参加を心よりお待ち申し上げます。
 2014ワークショップ実行委員会 委員長 山道 新太郎 (日本IBM)

申込方法

以下をご参考ください。申込受理後、事務局より参加登録券と請求書をお送り致します。

- 申し込み **当学会ホームページ (http://www.e-jisso.jp/) 掲載の「2014ワークショップ」を開いていただき、「参加申込はこちら」からお申し込みください。(https://bunken.org/jiep/event/jp/index.php?id=44)**
- 参加費用 正会員・賛助会員: ¥49,440、一般: ¥70,040、学生: ¥39,140
(宿泊費、食事、消費税を含みます。*なお一般の方は、同時に学会にご入会いただくと、初年度のみ年会費半額で、かつ今回のワークショップに**会員扱い**でご参加いただけます。)
- 申込締切 9月30日(火) (ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。)
- 定員 100名(先着申込順)
- 支払方法 請求書が届きましたら銀行振込でお支払いください。お申込み後のキャンセルはできませんので予めご了承ください。
- 申込先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 ワークショップ(修善寺)係
- 問合せ先 〒167-0042 東京都杉並区西荻窪北 3-12-2, Tel:03-5310-2010, Email:workshop@jiep.or.jp

アクセス



スケジュール

10月23日(木)		10月24日(金)	
13:00~	登録開始	08:00~09:00	朝食
13:30~14:00	オリエンテーション	09:00~09:15	受付開始
14:00~15:00	第1セッション (アブストラクトトーク)	09:15~10:20	第3セッション (アブストラクトトーク)
15:00~17:40	第1セッション (ポスター)	10:20~11:40	第3セッション (ポスター前半)
17:40~18:30	諸連絡・自由時間	11:40~12:30	昼食
18:30~20:30	夕食 (立食形式懇親会)	12:30~13:50	第3セッション (ポスター後半)
20:30~21:00	自由時間	13:55~14:55	特別講演
21:00~22:00	ナイトセッション	15:00~	アンケート・閉会式・現地解散
22:00~	第2セッション (部屋ごとに自由討論)		



プログラム

裏面へ!

特別講演 : 『マイクロ・ナノ医療デバイスの実装技術』 三木 則尚/慶応義塾大学
 ナイトセッション: 『魅力ある機能、品質でいかに儲けるか ~"時間の制御"にメスを入れた、ものづくりの全体最適化~』
 西岡 潔/東京大学

10月23日(木)	10月24日(金)
1. パワーモジュールのパッケージ技術動向 高橋 良和/富士電機	22. 工業用インクジェットを成功させる秘訣と失敗する理由 小澤 康博 / 石井表記
2. 機械的変形に起因するストレッチャブル印刷配線の電気伝導特性変化の解析とペースト設計への展開 井上 雅博/群馬大学	23. ナノインクの印刷と熱処理によるGaN系LEDの電極形成 - ウェットプロセスでもLEDは光る 柏木 行康/大阪市立工業研究所
3. 短タクト・高精度フレキシブル印刷TFT形成を実現する埋込フラット電極と一括焼成プロセス 日下 靖之/産総研	24. 低温焼結銀ナノインクの開発: 汎用プラスチック基材向け導電材料 寺河 俊紹/ダイセル
4. 熱拡散をシャットアウト 除熱剤「ヒートバスター」 梶田 雄三/PDM	25. パネルレベルパッケージ開発における熱解析精度向上 今泉 有加里/ジェイデバイス
5. 分子接合技術による超薄型4層フレキシブルプリント配線板の実現 林 芳如/東芝	26. Cu充填Al陽極酸化膜を用いた高密度3次元実装技術の開発 深澤 亮/新光電気工業
6. 絆創膏型デバイスの実装上の課題と一つの解決策 樋口 行平/アフォードセンス	27. 物質・エネルギーの未来を拓くスーパーコンピュータ 古宇田 光/東京大学
7. 次世代パッケージ向け高アスペクトめっき用レジストの開発 秋丸 尚徳/JSR	28. 次世代鉛フリーはんだ接合の動向 荘司 郁夫/群馬大学
8. Cu充填Al陽極酸化膜を用いた異方導電材料の基礎的物性 山下 広祐/富士フィルム	29. 銀ナノ粒子インクの印刷と銅めっきによる配線形成技術 富士川 亘/DIC
9. 半導体デバイスへの適用が広がるコンプレッションモールド技術 大西 洋平/TOWA	30. パターンめっきにおけるAu-Sn合金の酸化メカニズムの解明 中山 俊弥/東芝
10. 自己析出性樹脂による各種金属材料への絶縁性コーティング 豊島 幹人/日本パーカライジング	31. UV照射がリードフレーム上のAgめっき/Cuの密着性に及ぼす影響 奴留湯 誉幸/中央電子工業
11. 自己析出性樹脂の銅配線接着下地への応用検討 宮崎 雅矢/日本パーカライジング	32. 古くて新しい技術、薄膜キャパシタへの挑戦 服部 篤典/野田スクリーン
12. 実装基板、電子部品向けX線検査装置 小谷 和範/島津製作所	33. ミリ波を用いた血糖値計測の検討 黒子 美咲/国士舘大学
13. 人体通信によるウェアラブルコミュニケーション 加藤 康男/青山学院大学	34. 金属接合部のエレクトロマイグレーション発生メカニズムの基礎と信頼性課題 山中 公博/中京大学
14. 狭ピッチ対応極薄無電解Ni/Pd/Auプロセスの開発 大矢 怜史/クオルテック	35. 高品質を実現する狭ピッチCuピラーバンプ接合技術 下手 義和/ルネサスセミコンダクタ パッケージ&テストソリューションズ
15. アルミへの超音波はんだ接合の基礎検討 山崎 浩次/三菱電機	36. Znを用いた高耐熱接合技術 朴 聖源/大阪大学
16. はんだボール接続信頼性に及ぼす表面処理とはんだの影響 江尻 芳則/日立化成	37. 超薄型FOWLP用新材料の提案 近藤 和紀/信越化学工業
17. 高アスペクト比で層間接続可能な3次元積層構造体の提案 根岸 七生/オリンパス	38. 3次元LSIチップ積層に用いる円錐微細バンプ対応の3次元形状光学測定技術の開発 塩見 俊夫/ソフトウェア
18. ハイ・エンド フリップ・チップ・パッケージ製品向け低CTEインターポーザー基板の反りに関する考察 森 裕幸/日本IBM	39. 3Dインテグレーションのためのホットスポット対策技術 加藤 史樹/産総研
19. プリント配線板における最新めっき技術 中丸 弥一郎 /JCU	40. ユニークな発想を妨げない部品内蔵基板・超高密度実装技術とそれを支えるCAD/CAE技術 長谷川 清久/図研
20. モスキート法によるポリマー光導波路の3次元高密度配線 鈴木 球太, 菅沼 大輔, 石博 崇明/慶応義塾大学	41. 低コスト光実装を可能にする光硬化樹脂を用いたマスク転写技術とV溝実装への応用 榎本 忠幸, 三上 修/慶応義塾大学
21. 1次元熱回路網を用いたスレート型タブレット筐体の伝熱経路の検証 西 剛伺/日本AMD	42. パワーエレクトロニクス製品の実装技術動向 渡邊 裕彦/富士電機